

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024年05月09日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国兴 董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王韦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. sic的进展和产能规划状况</p> <p>答:尊敬的投资者您好。公司2023年6英寸SiC MOSFET产能已达到5000片/月。2024年公司将计划建成国内首条8英寸SiC MOSFET试验线。感谢您的关注。</p> <p>2. 小鹏汽车即是贵司汽车芯片的用户，又是贵司下属的专注碳化硅（SIC）业务的子公司芯联动力的股东，双方合作关系比较深入。请问，小鹏的飞行汽车项目，贵司有没有做相关的配合、协助开发，另外是否有用到贵司的相关芯片？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！小鹏汽车是公司的重要合作伙伴之一，合作产品及项目详细信息因涉及商业机密，具体信息请以公司公告为准。感谢您的关注。</p> <p>3. 请问，在机器人相关项目里，是否能用到贵司的相关芯片？贵司具体</p>

有哪些芯片，可应用于机器人领域？

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在AI服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。

2024年，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公司将继续加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。感谢您的关注。

4. 贵司公告的2024年4月12日的第六大流通股股东是王乐康，有一家半导体上市公司“明微电子”的董事长、法人代表、总经理也叫王乐康，请问是否是同一个人？如果是同一个人，那说明贵司确实很厉害，行业里的人肯定最了解行业内的公司，更何况是另一家半导体上市公司的老总。

答:尊敬的投资者您好，感谢您的关注，具体以公司公开披露的信息为准。

5. 贵司说：“新一代IGBT器件会在24年下半年量产，大幅提高单位晶圆片的芯片产出数量，实现营收的增长。”请问按照比例来说，芯片产出数量，大概能增加多少比例？

答:尊敬的投资者您好，公司新一代的IGBT技术，单位晶圆片的芯片产出数量会有20%-30%的提升。感谢您的关注。

6. 在AI人工智能，AI服务器，算力，数据中心等未来有巨大潜力的应用方向，贵司都做了哪些规划和储备，可以代工和生产哪些芯片。

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在AI服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。

2024年，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。新能源方向的应用领域主要覆盖新能源汽车和风光储市场；AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公司将继续加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。在AI服务器、数据中心等应用方向，高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核心技术。公司将在已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。

另外，公司将进一步完善消费终端布局，完整覆盖四大消费终端：手机，智能穿戴，笔电以及家电，尤其AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高集成度、安

全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计2024年有多个AI相关产品技术平台发布，全面支持AI加持的消费终端。感谢您的关注。

7.1、贵司说：“6英寸SiC MOS当前月产能5000片，产量饱满，计划今年扩产到1万片/月；公司12英寸硅基已实现月产能1万片，计划今年进一步扩产到3万片/月。” 请问扩产的SiC MOS 5000片/月、12英寸硅基2万片/月，按照目前的市场情况和价格，一年能产生多少营业收入？**2、贵司在建的8英寸碳化硅（SiC）产线，计划是今年4季度迭样，明年量产，请问8英寸碳化硅（SiC）产线，规划的产能是多少？**

答:尊敬的投资者您好，2024年公司SiC产品预计实现10亿元以上收入，同时，公司将计划年底建成国内首条8英寸SiC MOSFET试验线。公司已与多家头部车企进行合作，未来将继续拓展更多新能源汽车主机厂和零部件客户。随着产品验证的推进和产能的不断提升，SiC MOSFET产品上车数量将迅速提升，营业收入也将大幅增长，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封测领域的领先地位。感谢您的关注。

8.1、贵司今年一季度与理想汽车、蔚来汽车分别建立了合作关系，请问目前进展如何，是否已开始供货？ 2、比亚迪、小鹏汽车是贵司一直合作的老客户，今年一季度贵司荣获比亚迪颁发的“特别贡献奖”，以及小鹏汽车颁发的“合作协同奖”。请问今年一季度相比2023年一季度，贵司对比亚迪和小鹏汽车的芯片供应量，提升了多少？**3、贵司在今年一季度导入50家以上的新客户，是否预示贵司今年第二，三，四季度的营业收入，将比去年分别有较大的提升？**

答:尊敬的投资者您好！

（1）公司与理想汽车、蔚来汽车签署战略合作协议后，各项合作按计划顺利进展中。（2）公司与比亚迪、小鹏汽车的合作在不断深化中。（3）公司今年一季度导入50家以上的新客户，为今年第二、三、四季度，以及未来几年的营业收入的持续增长奠定了坚实的基础。

公司的产品成功进入新能源汽车的主驱逆变器、车载充电器、DC/DC系统、辅助系统等核心应用领域。感谢您的关注。

9. 贵司员工激励的业绩考核标准：“公司以2021-2023年营业收入均值为业绩基数，2024、2025、2026年累计营业收入定比业绩基数的增长率目标值分别不低于60%、254%、508%。” 请问按照该标准，贵司2024、2025、2026年分别最少要实现多少营业收入，员工算是完成业绩考核？请帮忙具体量化一下，大部分人才能看的懂。

答:尊敬的投资者您好！

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了本次激励计划。公司激励计划中的业绩考核指标的设定充分考虑了公司的经营环境以及未来发展规划等因素，具有良好的科学性和合理性，有利于增强核心团队的责任心，充分调动其积极性，从而提升公司竞争能力。

2023年公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破，成功推出了新产品，获得了多个重大客户定点。这些新产品的全面客户导入和大规模上量，将为2024年和2025年公司重新回到高速增长提供强大动力和坚强信心。公司在第二增长曲线SiC和第三增长曲线BCD的产能将根据技术产品的推进进度、市场需求的情况进行扩产。

感谢您的关注。

10. 公司预计啥时候能盈利？

答:尊敬的投资者您好，2023年公司在8英寸IGBT等功率器件、HVIC（BCD）等功率驱动、MEMS传感信号链等核心芯片及模组的产品方向上，持续增加研发投入，不断迭代出具有国际竞争力的产品；在SiC产线、12英寸硅晶圆产线、模组产线等方面做了详实的战略规划和项目布局，进行了大量的先进设备等资产投入及新产品研发投入。随着新建产能的快速释放，收入的迅速提升，以及折旧的逐步消化，公司在规模效应、技术领先性以及产品结构等方向的差异化优势将逐渐显现，将快速改善公司的盈利能力。感谢您的关注。

11. 请问，贵司具体有哪些芯片，是用在手机、笔记本电脑、平板电脑上的？

答:尊敬的投资者您好，在高端消费领域，2023年公司的超低压锂电池保护、MEMS麦克风、滤波器等产品线订单饱满。公司是国内最大的MEMS制造基地，2024年一季度公司高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的认证，平台和产品都在不断丰富和完善中；锂电池保护芯片实现大批量的国产替代；全系列智能功率模块产品，应用覆盖绿色智能家电等，已经开始批量生产。感谢您的关注。

12. 现在是主营负毛利？

答:尊敬的投资者您好，2024年一季度，公司实现营业收入13.53亿元，同比增长了17.2%；经营性现金流净额达到3.06亿元，同比增长了40.68%；实现EBITDA 4.82亿元，同比增长112%。

由于公司当前折旧金额较高，所以公司毛利率目前为负。2024年一季

度，通过收入的增长、成本控制和成本改善措施的推进，公司归母净利润为-2.42亿元，同比减亏了2.57亿元。随着公司进一步加强技术创新、工艺改进和降本增效，全力推动收入持续稳健增长，公司有信心2024年全年净利润将实现大幅减亏。感谢您的关注。

13. 请问芯联集成目前自主设计生产的SiC MOSFET芯片是否有大量用于汽车主驱逆变器？芯片良率怎么样

答:尊敬的投资者您好，公司的SiC MOSFET器件和模块主要应用于车载主驱逆变器中。目前公司SiC MOSFET产品保持高良率、高品质，还在持续的客户导入和量产爬坡中。感谢您的关注。

14. 目前产能是否过剩

答:尊敬的投资者您好！公司产品主要应用于新能源车为主的车载领域、风光储为主的工控领域以及高端消费电子领域，目前这些领域的核心模拟芯片和模组产品主要以进口为主。随着“双碳”目标的不断推进，新能源产业的进一步发展，功率半导体市场的需求持续稳步增长，叠加国产化率不断提升，市场需求有巨大的增量空间。

公司已拥有国内领先、国际一流的技术，致力于新能源、智能化产业的核心芯片及模组的开发，不断在技术上填补国内空白、实现国产替代。公司将持续通过与各类客户的广泛合作、联合研发，在所选择的技术和应用赛道上持续不断的努力，力争成为该赛道上全球第一梯队的重要一员。感谢您对公司的关注！

15. 今年一季度以来，公司众多业务板块，营收和增幅比例是怎样的？哪个板块是增长最大的？

答:尊敬的投资者您好，受益于消费市场的持续回暖，公司一季度消费业务收入同比实现翻倍增长。公司是国内最大的MEMS制造基地，高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的认证，平台和产品均在不断丰富和完善中；锂电池保护芯片实现大批量的国产替代；公司研发出全系列智能功率模块产品，应用覆盖绿色智能家电，已经开始批量生产。感谢您的关注。

16. 公司在2024年第一季度营业收入增长17.19%的驱动因素是什么？

答:尊敬的投资者您好，今年第一季度，随着市场需求的复苏，公司产线开工率在稳步的提升中。公司深耕新能源、智能化市场，坚持技术创新和精益经营，实现了收入的稳定增长。感谢您的关注。

17. 2024年公司还将计划建成国内首条8英寸SiC MOSFET试验线，该试验线目前进展如何？

答:尊敬的投资者您好，公司8英寸SiC产线建设进展顺利，今年二季度将完成通线，四季度开始正式向客户送样，2025年进入规模量产。感谢您的关

注。

18. 请问未来的发展战略和目标是什么？公司将如何实现这些目标？谢谢

答:尊敬的投资者您好，公司的未来发展战略和经营计划详细请参考公司《2023年年度报告》第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析。感谢您的关注。

19. 尊敬的财务负责人，您好！贵公司去年获得财政补助专项资金，请问今年是否还有？

答:尊敬的投资者您好，根据相关政策，2024年公司仍将获得各类补助资金。具体以公司披露的信息为准。感谢您的关注。

20. 报告期公司在研发投入上大幅增加36.32%，主要集中在哪些项目或技术领域？公司如何积极布局未来的技术发展？

答:尊敬的投资者您好，随着市场需求复苏，为了保障公司在未来市场旺盛需求阶段中能获得和巩固更多中高端技术及产品的市场份额，公司继续在12英寸车规级BCD平台、SiCMOSFET、功率模组等方面保持足够的研发投入强度。（1）车载领域高压BCD、嵌入式数模混合控制BCD等平台发布；全新一代车载IGBT芯片和多款SiC模块以及混碳模块样品已在客户端验证通过，开始大规模客户导入和量产起量。（2）风光储充等工控领域结合终端多款新机型应用需求，公司研发并导入了多款产品，如大功率光伏逆变产品，大功率储能PCS产品和面向高压大功率风电的高功率产品，为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT、SiC芯片及模块。（3）家电应用领域研发出全系列智能功率模块产品，产品应用覆盖绿色和智能家电，已开始批量生产。

高质量的研发投入是公司长期发展的基石和竞争力的保障。这些研发成果带动公司在报告期内导入新客户50多家，客户覆盖汽车领域的国内外主机厂和Tier 1，以及风光储、家电领域等行业头部，为未来收入的快速增长奠定了基础。感谢您的关注。

21. 尊敬的财务负责人，您好！公司何时能够获得高新技术企业认定，有这方面财务筹划吗？

答:尊敬的投资者您好，公司已获得高新技术企业认定。感谢您的关注。

22. 目前公司在12英寸车规级BCD平台和SiC MOSFET等关键技术领域的研发进展如何？

答:尊敬的投资者您好，

在12英寸产品方面，公司BCD专注在高电压、大电流、高可靠性的车载和工业应用上，已经完整搭建覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平台，客户覆盖国内外众多头部IC客户，涵盖汽车、新能源和高端消费

类等领域。一季度公司多个模拟高压平台进入量产；嵌入式集成功率器件在车载高低边开关应用广泛推广，获得多个客户定点；发布了高压BCD平台，嵌入式数模混合控制BCD平台获得国内重要终端车厂定点。公司已通过全球知名汽车Tier1车规IC审核，获得最高等级A级认证，优异的产品品质获得客户认可。

在SiC MOSFET产品方面，作为国内稀缺的实现了SiC MOS主驱逆变器规模量产的企业，公司一季度SiC MOS满载生产，产量持续提升，产品保持高良率、高品质，收入环比继续增长。感谢您的关注。

23. 根据公司对下游市场客户需求的感知，2024年二季度市场情况如何？

答:尊敬的投资者您好，展望未来，随着半导体行业的持续复苏，公司将加速产品迭代和推动新产品量产。车载应用方向：持续提升SiC产能，扩大市场领先优势，快速推进模拟IC在客户的量产应用；消费应用方向：推动AI手机、家电、笔电市场的产品导入；工控市场应用方向：全面推动风光储网算5个方向产品布局和市场渗透。同时，公司进一步加强技术创新、工艺改进和降本增效，全力推动收入持续稳健增长，实现净利润大幅减亏。感谢您的关注。

24. 董秘您好，请问公司在车载领域和工控领域的研发成果如何转化为实际的营业收入？

答:尊敬的投资者您好，公司按照“技术+市场”双轮驱动的策略，秉承与客户共同研发的机制，增加了客户的粘性及稳定度。一方面公司持续对已经居于国际前列的器件进行快速迭代，保持技术的领先优势，另一方面不断加深与客户的全方位合作，获得客户的多项定点。感谢您的关注。

25. 公司明天将有大量限售股解禁，公司目前是否有收到5%以上股东减持的通知？

答:尊敬的投资者您好，根据公司于2024年4月20日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029），“公司持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述期间实施股份减持计划，将按相关规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务”。感谢您的关注。

26. 未来是否有计划进一步扩大在新能源汽车、智能家电或其他新兴市场的业务？

答:尊敬的投资者您好，2023年，公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破，成功推出了新产品，获得了多个重大客户定点。这些新产品的全面客户导入和大规模上量，将为2024年和2025年公司实现高速度增长提供强大动力和坚强信心。

(1) 汽车电子：在电动化方面，技术创新加精益经营推动更高性价比的产品快速迭代，进一步助力新能源汽车电动化的渗透。智能化方面，全面推进智能化产品进入汽车终端。多个应用传感器实现规模量产，高集成智能控制和电源管理产品全面发布，全车智能系统产品覆盖率大幅度提高。

-电动化方面：功率半导体特别是先进SiC芯片及模块进一步扩大市场份额。技术创新加精益经营，为市场带来更具性价比的产品。车载模拟IC推出多个国内领先和全球先进的技术平台，填补国内高压大功率数字模拟混合信号集成IC的空白。在已赢得多个重大项目定点的基础上，进一步推动汽车电源管理和智能控制的全栈解决方案。

-智能化方面：激光雷达核心芯片全面扩展客户导入和市场渗透，快速提高市占率。多个传感器项目包括高精度惯性导航传感器，压力传感器，高性能车载麦克风进入智能汽车终端，全面助力汽车智能化的发展。

(2) 工业：全面推进风光储网算5个方向产品布局和市场渗透。-AI服务器、数据中心等应用方向：高效率电源管理芯片日益显现为AI和大型数据中心的核​​心技术。在已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点的基础上，全面推动产品导入和市场渗透。

-风光储充方向：为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT、SiC芯片及模块；大功率工商业、地面光伏、储能扩大市场占有率；全面导入风电客户。

-智能电网方向：2023年作为特高压直流输电的核心器件超高压IGBT产品已在多地挂网使用，2024年将展开新一代产品研发，全面支持双碳目标下的特高压直流智能电网高速建设。

(3) 消费：进一步完善消费终端布局，完整覆盖四大消费终端：手机，智能穿戴，笔电以及家电；尤其AI在消费终端的兴起，给半导体在消费电子领域提出更多技术需求：包括强大的处理能力、低功耗、高集成度、安全性和可靠性等，也为半导体在消费电子领域带来巨大的机遇。公司会进一步加大相关产品的研发投入，加速产品开发速度，预计2024年有多个AI相关产品技术平台发布，全面支持AI加持的消费终端。

-手机以及可穿戴：AI大势已至，作为用户量最广、用户粘性最高的智能终端，手机会成为AI大爆炸大普及的第一载体。公司将进一步扩大已经占据市场和技术领先位置的传感器和电池管理保护产品的优势地位，同时针对AI phone带动的相关新技术需求加大研发投入，快速实现产品导入。

-笔电：消费类产品进一步拓展至笔电终端。

-家电：在已经推出系列产品和实现多个重大客户突破的基础上，推动大规模量产，扩大市场占有率，同时加快新技术研发，推动家电半导体技术进

步。

感谢您的关注。

27. 尊敬的赵总，您好！公司在技术成果方面积累了一定数量的发明专利，这些发明专利在科技成果转化方面为公司的发展取得多少发展效率？

答：尊敬的投资者您好，2023年公司共提出知识产权申请295项，获得专利102项。2023年度公司实现主营业务收入49.11亿元，比上年同期增加9.52亿元，同比增长24.06%。2024年一季度，公司实现营业收入13.53亿元，同比增长了17.2%。研发项目和知识产权的积累为公司收入增长奠定了稳定的基础。感谢您的关注。

28. 贵司的研发投入占营收收入的研发占比，几乎是目前半导体上市公司里最高的。好的一面是，确保了贵司在所涉足的领域，技术基本是国内最领先的，也处于全球第一梯队。但贵司2018年才成立，已建成的产线产能还不够大，技术的领先，受制于产能，还没有实现相匹配的营收规模。请问，基于贵司技术的领先性，贵司是否有考虑，在未来兼并一些芯片代工厂，或者合作一些芯片代工厂，以提高产能，使贵司先进的技术，达到利益最大化。

答：尊敬的投资者您好，目前公司8英寸硅基已达月产17万片（其中IGBT月产8万片，MOSFET月产7万片，MEMS月产1.5万片以及HVIC月产0.5万片），通过效率提升、工艺调整，8英寸硅基产线的产能视市场需求进一步提升；SiC MOS当前月产能5000片，产量饱满，计划今年扩产到1万片/月；公司12英寸2023年年底已实现月产能1万片，今年计划进一步扩大到月产能3万片。

随着市场需求的复苏，为了能迎接旺盛的市场需求，获得和巩固更多中、高端技术及产品的市场份额，公司将继续在12英寸车规级BCD平台、SiC MOSFET、功率模组等方面保持足够的研发投入强度，为未来收入的快速增长奠定基础。感谢您的关注。

29. 报告期公司的现金流量净额增长40.68%，这是否表明公司的现金流状况有所改善？

答：尊敬的投资者您好，2024年一季度公司经营性现金流净额达到3.06亿元，同比增长了40.68%；同时实现EBITDA 4.82亿元，同比增长112%。公司经营活动现金流状况一直处于良好的状况。感谢您的关注。

30. 为何目前公司经营依旧为收入小于成本，毛利为负

答：尊敬的投资者您好，2024年一季度，公司实现营业收入13.53亿元，同比增长了17.2%；经营性现金流净额达到3.06亿元，同比增长了40.68%；实现EBITDA 4.82亿元，同比增长112%。

由于公司当前折旧金额较高，所以公司毛利率目前为负。2024年一季度，通过收入的增长、成本控制和成本改善措施的推进，公司归母净利润为-

2.42亿元，同比减亏了2.57亿元。随着公司进一步加强技术创新、工艺改进和降本增效，全力推动收入持续稳健增长，公司有信心2024年全年净利润将实现大幅减亏。感谢您的关注。

31. 尊敬的赵总，您好！公司的SiC MOS和IGBT 代工与模组封装细分领域技术分别在国内和国际市场的排名如何？

答:尊敬的投资者您好，公司的SiC MOSFET技术对齐国际水平，产品主要应用于车载、工控等领域，随着技术的不断迭代，公司将完成750V-1700V全电压系列工艺技术开发，形成规模化的晶圆制造代工能力；IGBT技术方面，公司应用于车载及工控的核心芯片领域的IGBT产品技术已比肩国际先进水平。公司的工厂均按照车规要求建设，是国内最大的车规级IGBT生产基地。模组封装方面，公司IGBT模组已全面覆盖国内头部企业，其中，车规级模组全面覆盖中国主力车厂及系统厂商；风电光伏模块系列完整，全面覆盖中国主力系统厂商，并启动头部工控模块联合开发项目；IPM全品类送样，客户覆盖主流家电厂商。公司的SiC车规级模组和单面水冷模块已实现规模量产，多家客户定点，逐步提升公司在中国车载模块的市场份额。感谢您的关注。

32. 董事长，公司的EBITDA增长111.97%，请问这一增长是否可持续？

答:尊敬的投资者您好，2024年一季度，实现EBITDA 4.82亿元，同比增长112%；同时公司经营性现金流净额达到3.06亿元，同比增长了40.68%。随着收入的增长、成本控制和成本改善措施的推进，公司的EBITDA将持续向好。感谢您的关注。

33. 目前在车载IGBT芯片和SiC模块的客户端验证情况如何？是否有大规模订单或合同？

答:尊敬的投资者您好，目前公司车载领域全新一代车载IGBT芯片和多款SiC的模块已在客户端验证通过，获得多个定点，已在规模量产中，产量还在不断提升。感谢您的关注。

34. 在风光储充等工控领域的产品线扩展情况如何？请问领导是否有新的产品或技术即将推出？

答:尊敬的投资者您好，风光储充等工控方向上，结合终端多款新机型应用需求，公司研发并导入了多款产品，如大功率光伏逆变产品，大功率储能PCS产品和面向高压大功率风电的高功率产品，为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT，SiC芯片及模块。感谢您的关注。

35. 各位领导好，公司在家电应用领域的智能功率模块产品的研发和市场接受度如何？

答:尊敬的投资者您好，目前，公司在家电应用领域已研发出全系列智能

	<p>功率模块产品，产品应用覆盖绿色和智能家电，并已开始批量生产。感谢您的关注。</p> <p>36. 请问养老和社保基金，共持有贵司多少股份？都是5.69元/股的发行价认购的吧？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，全国社会保障基金理事会合计认购15,668.13万股，认购价格为5.69元/股。详情可查看公司2023年5月5日于上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。感谢您的关注。</p> <p>37. 请问贵司的一期8英寸产线，目前已经完成了多少折旧额，还剩余多少金额未完成折旧？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司2018年成立，2019年8英寸晶圆产线通线进入量产，于2021年达到10万片/月产能，于2023年达到17万片/月产能。公司主要生产设备采用5-10年的折旧年限，目前已有部分设备正陆续出折旧期。感谢您的关注。</p> <p>38. 贵司的智能传感器芯片，是否有机器人的相关企业已经开始应用，还是处于研发配合阶段？请问具体处于哪个阶段？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司AI相关方向应用领域主要覆盖大算力服务器的电源管理和机器人市场。公司正在推进智能电源管理模块、智能传感器芯片等产品在机器人领域的应用。感谢您的关注。</p> <p>39. 今年一季度以来，公司众多业务板块，营收和增幅比例是怎样的？哪个板块是增长最大的？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，受益于消费市场的持续回暖，公司一季度消费业务收入同比实现翻倍增长。公司是国内最大的MEMS制造基地，高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的认证，平台和产品均在不断丰富和完善中；锂电池保护芯片实现大批量的国产替代；公司研发出全系列智能功率模块产品，应用覆盖绿色智能家电，已经开始批量生产。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月09日